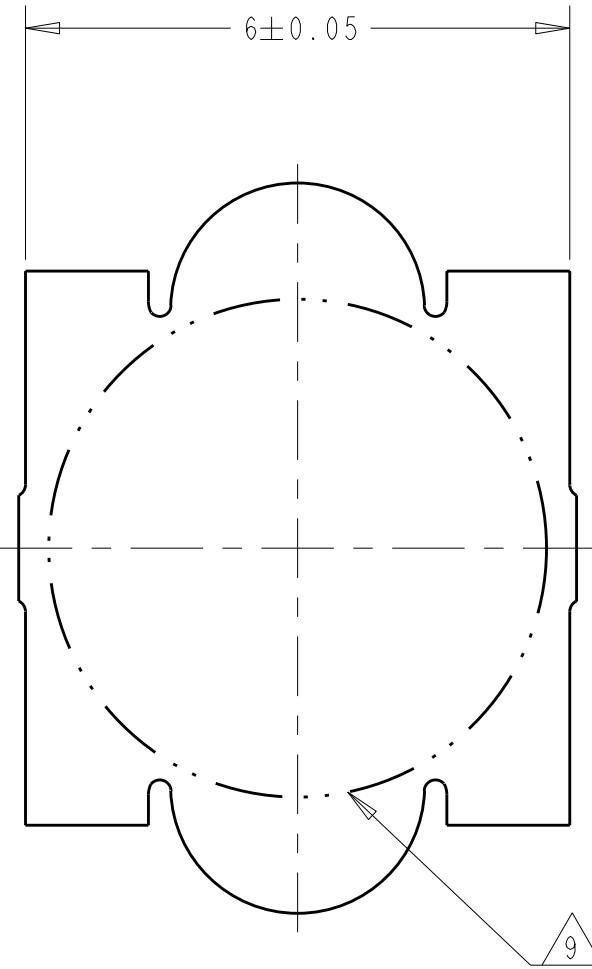
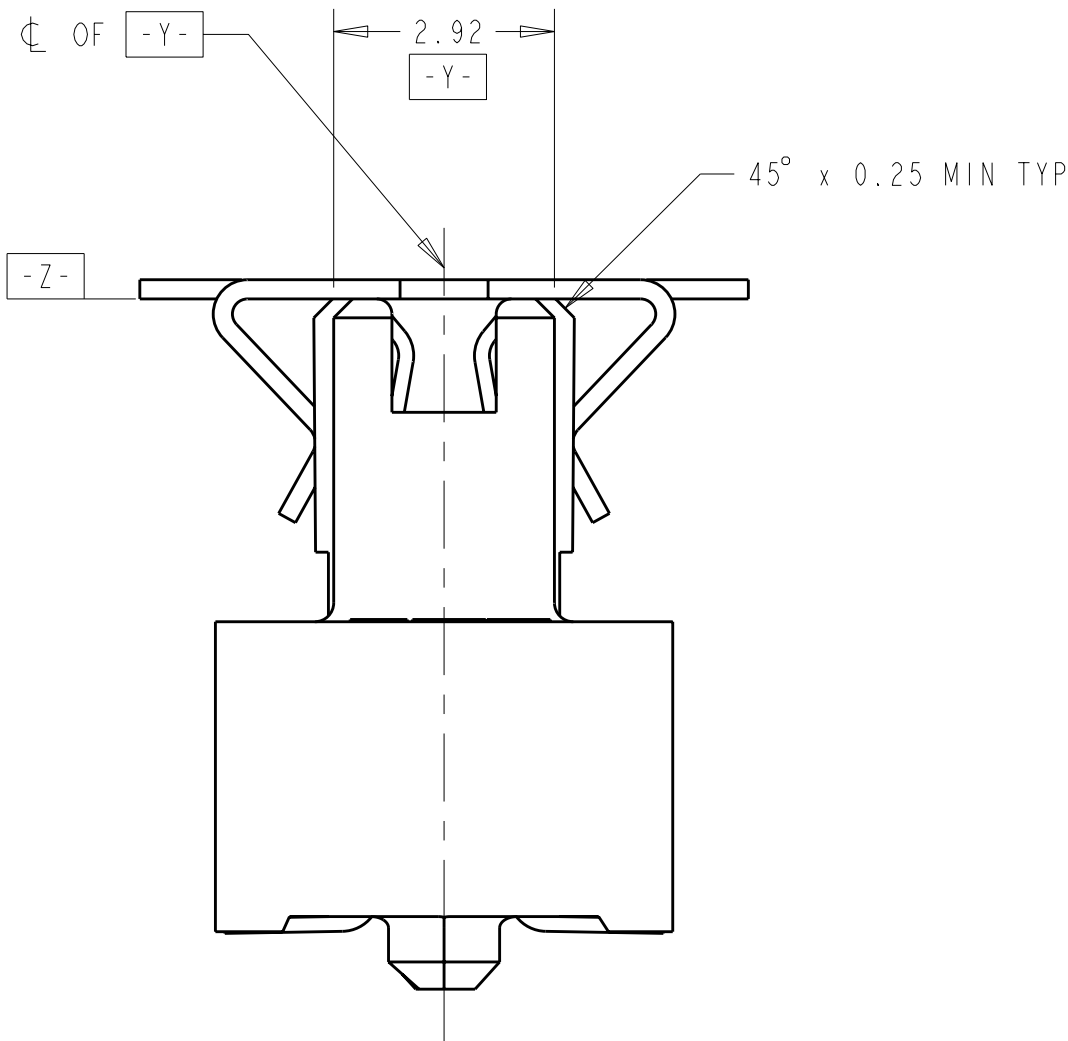


LOC	DIST	REVISIONS							
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
		H		REVISED PER EC	0S12-0072-04		12FEB2004	RWS	RHW
		J		REV PER ECO-06-026075			06FEB2007	BC	DB
		K		REVISED PER ECO-08-008615			10JUL2008	DH	DB
		KI		REVISED PER ECO-09-018464			26AUG2009	AEG	DD

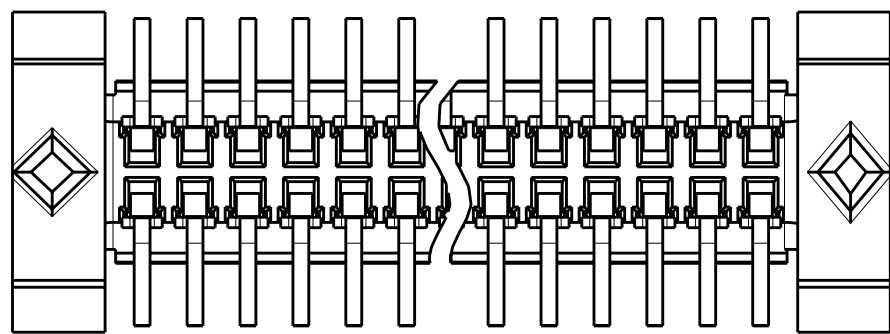
1. HOUSING MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK.)
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
2. CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, MATING SURFACES
PLATED TO MEET PL1 PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY
SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN-LEAD.
3. DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE
CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE
CONNECTORS ON A PC BOARD.
4. PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.
5. 1.4±0.05 DIAMETER HOLE WHEN PLACING BY HAND.
6. SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.4
LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF
MANUFACTURER OF CONNECTOR.
7. REFERRED TO AS DIM H = 8.3±0.1 IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.
8. VACUUM COVER NOT SHOWN IN SOME VIEWS FOR CLARITY.
9. 5.5 MIN DIAMETER TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
10. CONTACT FINISH: 0.00381 MINIMUM MATTE TIN-LEAD (93-7)
ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD ON MATING AREA,
BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
11. SQUARE AND DIAMOND SHAPED POSTS.
12. ROUND SHAPED POSTS.



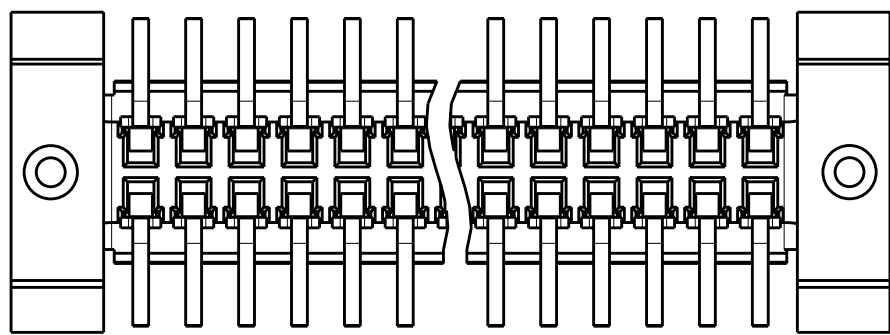
VACUUM COVER



STYLE A POSTS

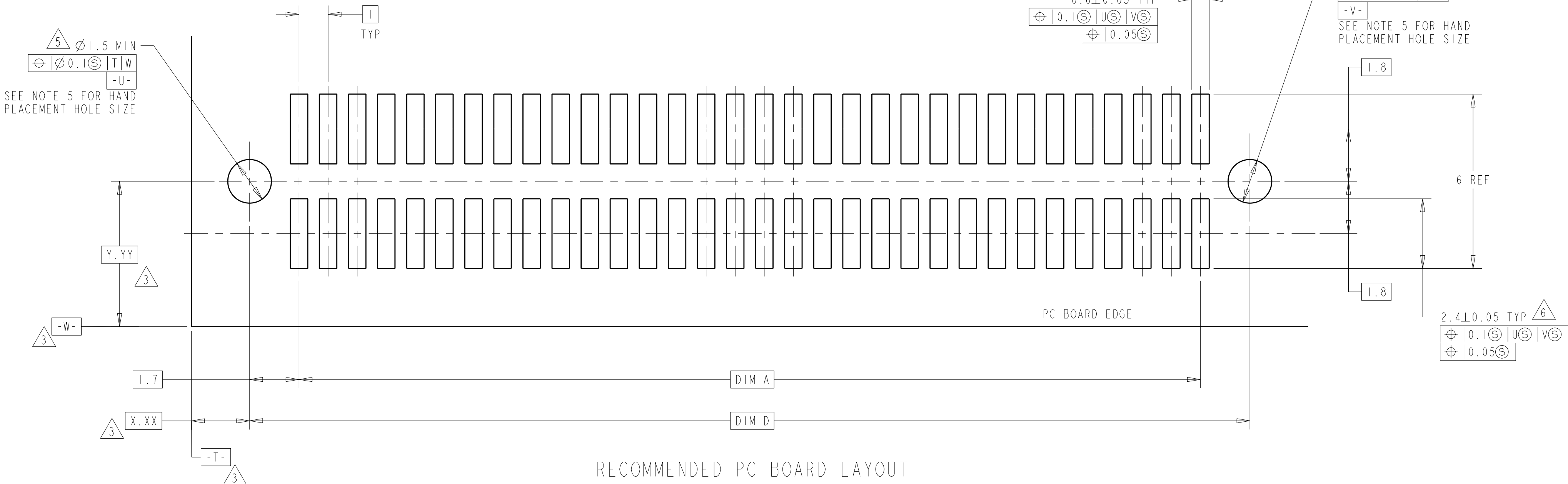
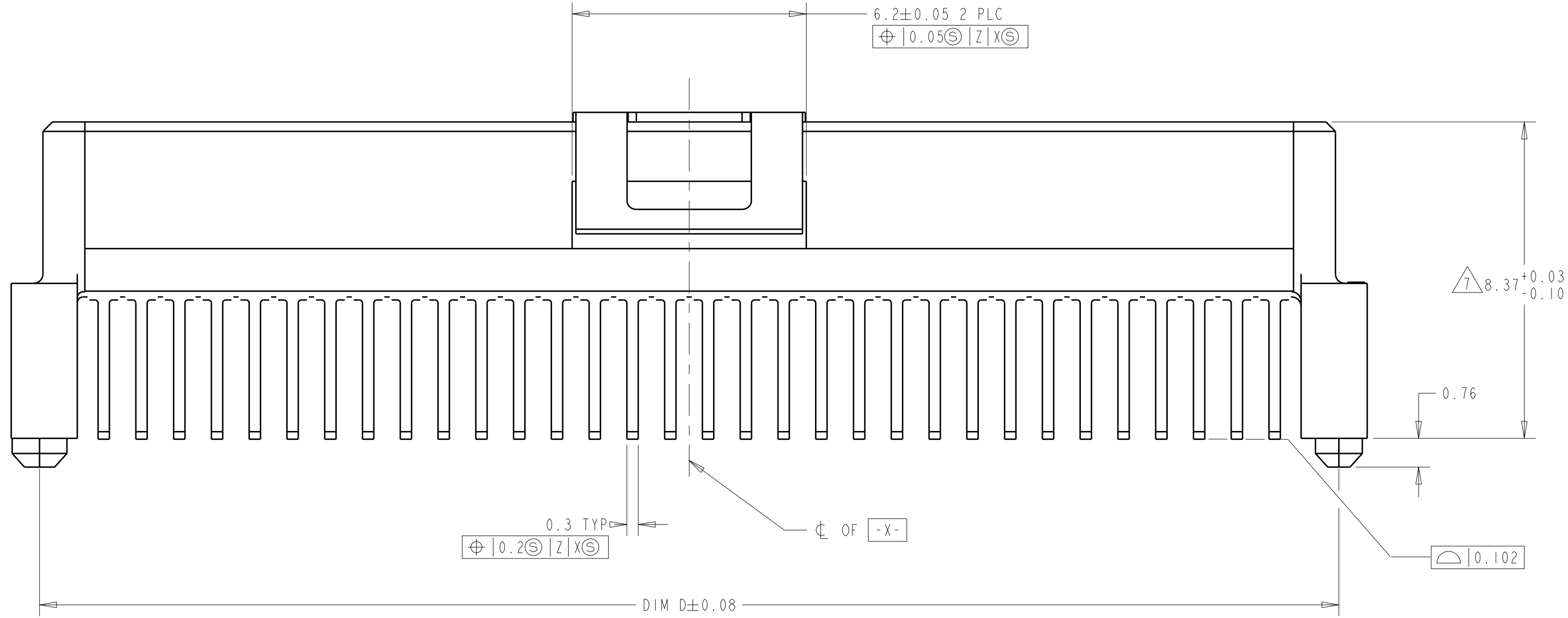
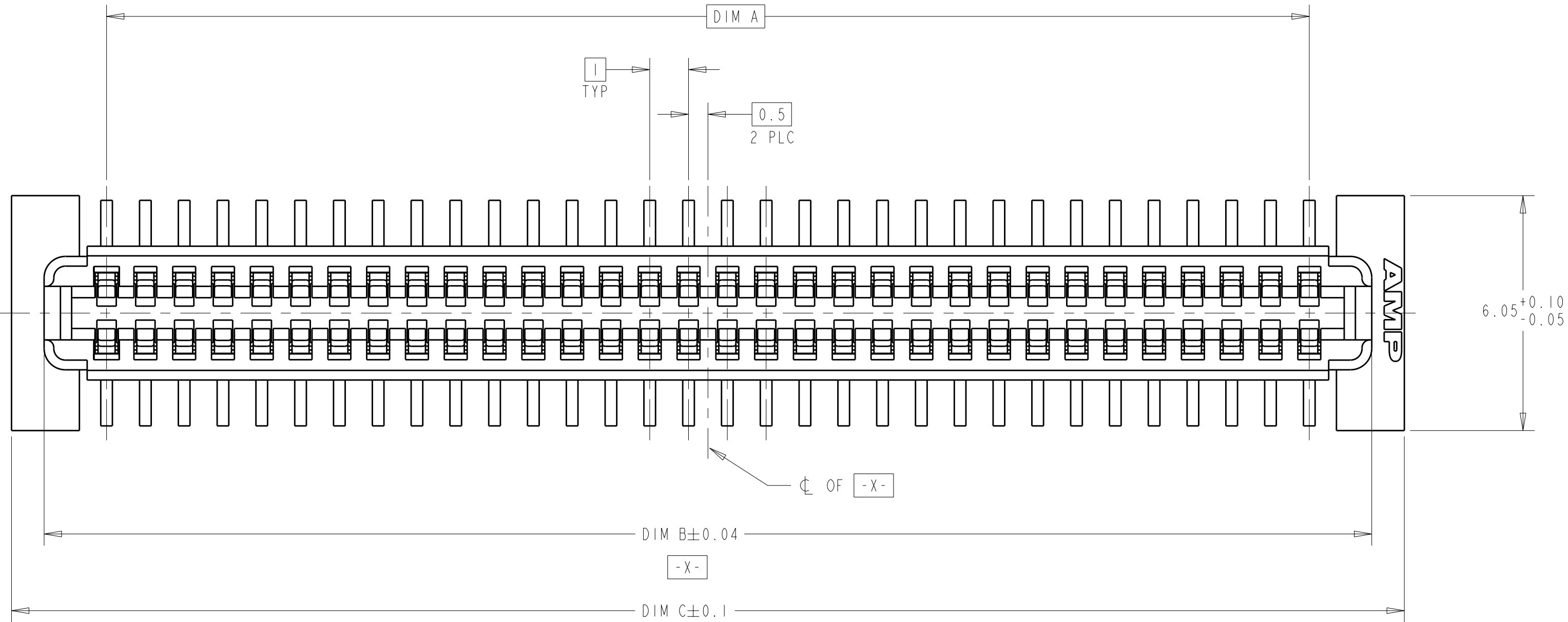


STYLE B POSTS



POST	STYLE	FINISH	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	STACK HEIGHTS	POS	AMP PART NUMBER
2	2	10	44.4	45.9	44.22	41	13	84	3-146895-2
2	2	10	34.4	35.9	34.22	31	13	64	3-146895-1
2	2	2	44.4	45.9	44.22	41	13	84	2-146895-2
2	2	2	34.4	35.9	34.22	31	13	64	2-146895-1
1	1	10	44.4	45.9	44.22	41	13	84	1-146895-2
1	1	10	34.4	35.9	34.22	31	13	64	1-146895-1
1	1	2	44.4	45.9	44.22	41	13	84	146895-2
1	1	2	34.4	35.9	34.22	31	13	64	146895-1

TYPICAL DIMENSIONS TO BE USED FOR THE CUSTOMER'S DESIGN ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN D.K. SCHRUM 31JUL98	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		CHK CHAD BAKER APVD	NAME RECEPTACLE ASSY, W/ VACUUM COVER, 1.0mm FH(IEEE 1386) CONNECTOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC 502-1079	SIZE 114-25045	
9 PLC ± 2 PLC ±0.03 3 PLC ±0.003 4 PLC ± ANGLES ±0°30'		APPLICATION SPEC	WEIGHT -	
MATERIAL 1		FINISH SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING	
			A1 00779 C=146895	
			SCALE 10:1 SHEET 1 OF 1 REV KI	



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9